



Fraunhofer COMEDD erweitert Kompetenzen des Fraunhofer FEP

Fraunhofer COMEDD erweitert Kompetenzen des Fraunhofer FEP
Im Zuge der Bündelung von Kompetenzen an einem Standort beschloss die Fraunhofer-Gesellschaft, das Fraunhofer COMEDD mit dem Fraunhofer FEP zusammenzuschließen. Nunmehr werden ab 1. Juli 2014 die Arbeiten zu organischer Elektronik unter dem Namen COMEDD am "Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl-, Plasmatechnik und COMEDD" - kurz "Fraunhofer FEP" - weitergeführt.
Prof. Volker Kirchhoff, Leiter des Instituts, freut sich über die neuen Möglichkeiten: "COMEDD ist gegenüber dem bisherigen FEP-Fokus auf Technologien und Prozesse zusätzlich auf Bauelemente und Anwendungen ausgerichtet. Insbesondere auf dem Gebiet der Barrierefolien für flexible organische Bauelemente erwarte ich durch die Erfahrungen des COMEDD signifikante Fortschritte. Aber auch die OLED-Mikrodisplays werden von den langjährigen Arbeiten in der Prozesstechnik oder den Marktbeziehungen am Fraunhofer FEP profitieren." Dies sind nur zwei Ansatzpunkte von vielen, die derzeit intern diskutiert werden. Das Fraunhofer FEP ist für seine Prozess- und Anlagenkompetenz bei der Elektronenstrahl- und Plasmatechnik bekannt, währenddessen das COMEDD einzigartiges Know-How auf dem Gebiet der organischen Halbleiter und der Bauelemente-Entwicklung mitbringt. Die Wissenschaftler sind überzeugt, Ihren Kunden und Partnern künftig neuartige Entwicklungen durch die vereinten Kompetenzen anbieten zu können. Denkbar ist beispielsweise, die am FEP entwickelte Sterilisation per Elektronenstrahl auf OLED-auf-Silizium-Sensoren von COMEDD für den Einsatz in biomedizinischen Anwendungen erfolgreich einzusetzen.
Dr. Uwe Vogel, stellvertretender Institutsleiter und Bereichsleiter Mikrodisplays und Sensoren bekräftigt: "Der Zusammenschluss von COMEDD und FEP ist ein wegweisender Schritt für die künftigen Entwicklungen und Aktivitäten von Fraunhofer in Dresden und am Standort für Organische Elektronik Sachsen. Dadurch können neue Ansätze und Forschungsschwerpunkte - zum Beispiel zur flexiblen Elektronik - effektiver bearbeitet werden. Vorgegangene langjährige gemeinsame Projekte zwischen FEP und COMEDD mit signifikanten Erfolgen - zum Beispiel bei der Entwicklung der Rolle-zu-Rolle-Technologie für flexible organische Beleuchtung - sind bereits eine gute Grundlage für die künftige Zusammenarbeit. Die Mitarbeiter kennen sich, sind bereits gut vernetzt. Wir vom COMEDD schätzen besonders die offene und professionelle Art der Mitarbeiter des Fraunhofer FEP im Zuge der Integration." Kunden und Partner können weiterhin auf allen fachlichen Gebieten mit den bisherigen Ansprechpartnern zusammenarbeiten - für sie ergibt sich zudem eine Komplettierung und Erweiterung der Angebotspalette an Dienstleistungen. Für das neue Institut gelten alle von FEP oder COMEDD geschlossenen Verträge und Geheimhaltungsvereinbarungen weiter.
Über Fraunhofer FEP:
Das "Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl-, Plasmatechnik und COMEDD (FEP)" bearbeitet innovative Themenstellungen auf den Arbeitsgebieten der Vakuumbeschichtung, der Oberflächenbearbeitung und -behandlung mit Elektronen und Plasmen und der organischen Halbleiter. Grundlage dieser Arbeiten sind die Kernkompetenzen Elektronenstrahl-, Sputtertechnologie, plasmaaktivierte Hochratebedampfung, Hochrate-PECVD sowie Technologien für organische Elektronik und IC-/Systemdesign.
Fraunhofer FEP bietet damit ein breites Spektrum an Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotfertigungsmöglichkeiten, insbesondere für Behandlung, Sterilisation, Strukturierung und Veredelung von Oberflächen sowie für OLED-Mikrodisplays-, organische und anorganische Sensoren, optische Filter und flexible OLED-Beleuchtung.
Ziel ist, das Innovationspotenzial der Elektronenstrahl-, Plasmatechnik und organischen Elektronik für neuartige Produktionsprozesse und Bauelemente zu erschließen und es für unsere Kunden nutzbar zu machen.

Pressekontakt

Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP

01277 Dresden

Firmenkontakt

Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP

01277 Dresden

Als eines von 67 Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, Europas größter Organisation für angewandte Forschung, widmet sich das Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP in Dresden der Entwicklung von Technologien und Prozessen zur Oberflächenveredelung. Unsere Kerntechnologien, die Sputtertechnologie, die plasmaaktivierte Hochratebedampfung, die Hochrate-PECVD sowie die Elektronenstrahltechnologie nutzen wir zur Lösung vielfältiger, industrieller, Problemstellungen der Oberflächentechnologie. Die Abscheidung von Einzelschichten und Mehrlagen-Schichtsystemen sowie die Bearbeitung von Oberflächen haben große praktische Bedeutung über alle Geschäftsbranchen hinweg. Ob im Maschinenbau, bei der Nutzung von Solarenergie, in der Verpackungsindustrie, der Biomedizintechnik oder in der Optik, Sensorik und Elektronik: Wir entwickeln passende Prozesse und Technologien sowie die dazugehörigen technologischen Schlüsselkomponenten. Machbarkeitsstudien, um Aufgaben der Oberflächenbeschichtung oder -bearbeitung zu evaluieren, oder die Pilotproduktion zur Unterstützung der Markteinführung neuer Produkte unserer Kunden gehören außerdem zu unserem Leistungsspektrum. Die Aufskalierung der Technologien auf einen industriellen Maßstab sowie die Integration in eine geeignete Anlagentechnik und in bestehende Fertigungsverfahren sind wesentliche Dienstleistungen des Institutes. Die Kosteneffizienz der Technologien beim Einsatz in der industriellen Produktion behalten wir dabei immer im Blick. Unser umfangreiches Know-how ermöglicht es uns, unsere Kunden in ihren Forschungs- und Entwicklungsprojekten von der Konzeptphase bis zur industriellen Umsetzung zu begleiten.